

2024日本国际电子科技展览会 NEPCON JAPAN

产品名称	2024日本国际电子科技展览会 NEPCON JAPAN
公司名称	贸升展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号1990室
联系电话	13584942208 13584942208

产品详情

2024日本国际电子科技展览会

NEPCON JAPAN

展会时间：2024年09月04-06日；日本千叶幕张展览馆

展会时间：2024年10月23-25日；日本名古屋国际会展中心

展会时间：2025年01月22-24日；东京Big Sight 展览馆

展会规模：约1200家参展商； 参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

不参展人员：我司可提供随团观展服务，提供签证，机piao，酒店，接送机，入场证等服务

我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，五年多次）材料简单，出签快

展会介绍

作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备 & 开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印shua电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”的场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

市场介绍

日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居列。此外，以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。在返个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业行

入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5亿美元，总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

构成展会

NEPCON JAPAN日本电子科技博览会由六大展会组成：

1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN

汇集了各种电子产品制造及SMT所用设备、解决方案、技术及服务。

2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：

亚洲的电子研发制造领域有关测试，检查，测量和分析技术的展会。

3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP

亚洲的集成电路制造展！汇集了各种先进的设备、材料及服务。

4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO

亚洲！汇集各种电子元件和材料

5、印shua电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo

装配设备、保证材料/组件、IC封装汇集了如PCB材料，设计开发委托服务与设计工具软件等各种PCBs/PWBs及技术。

6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

电子制造领域精密加工技术专门展！诸如模具制造、切削、冲压加工、蚀刻等各种精密·微细加工技术汇聚一堂！

展览范围

电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

印shua电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属

成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

我司组展优势：

- 1、良好的摊位位置和价格优势。
- 2、境外行程和酒店食宿等安排一向优惠合理便捷，得到广大参展商和商务考察企业单位的！
- 3、常年操作外展经验和熟悉当地国家情况的带团人员。
- 4、从摊位确认到展台搭建及展览品运输和商务签证培训与补贴办理，公司一条龙的服务理念，打造展览服务行业品牌！

2024年6月日本无人机展览会Japan Drone----千叶

2024年9月日本科学仪器及分析测试仪器设备展览会JASIS----千叶